

<<电子工艺与电子CAD>>

图书基本信息

书名：<<电子工艺与电子CAD>>

13位ISBN编号：9787560614304

10位ISBN编号：7560614302

出版时间：2004-8

出版时间：西安电子科技大学出版

作者：朱旭平 编

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电子工艺与电子CAD>>

内容概要

本书系统地介绍了电子工艺和电子CAD的基本常识。

全书共分7章，内容包括：电子工艺工作、电子设备的可靠性设计、电子整机装配工艺、Protel DXP基础、原理图设计基础、制作元件及元件封装和印制电路板的设计。

本书是根据对电子信息类人才知识技能的要求，结合高职人才培养突出实践训练的特点编写的，是一本集电子工艺基础知识和电子CAD技术于一体的教材。

本书注重内容的实用性，符合高职培养“生产一线的应用型、技能型、操作型人才”的目标，能培养学生的综合应用技能和动手能力。

本书可作为高职高专电子信息类、自动化类专业教材，也可作为电子工程技术人员的参考用书。

书籍目录

第1章 电子工艺工作 1.1 工艺工作概述 1.2 电子产品工艺工作程序 1.2.1 电子产品工艺工作流程图
1.2.2 方案论证阶段的工艺工作 1.2.3 工程设计阶段的工艺工作 1.2.4 设计定型阶段的工艺工作
1.2.5 生产定型阶段的工艺工作 1.3 电子产品制造工艺技术 1.3.1 电子产品制造工艺技术的种类
1.3.2 电子产品制造工艺技术的管理 1.4 电子产品技术文件 1.4.1 工艺文件 1.4.2 设计文件 思考题
与练习题 实训：编制工艺文件 第2章 电子设备的可靠性设计 2.1 影响电子设备可靠性的主要因素
2.1.1 工作环境 2.1.2 使用方面 2.1.3 生产方面 2.2 电子元器件的选用 2.2.1 电子元器件的选用准则
2.2.2 电子元器件的主要技术参数 2.2.3 电子元器件的降额使用 2.2.4 电子元器件的检验与筛选
2.3 电子设备的可靠性防护措施 2.3.1 电子设备的散热防护 2.3.2 电子设备的气候防护 2.3.3 电子
设备的电磁防护 2.4 印制电路板布线的可靠性设计 2.4.1 电磁兼容性设计 2.4.2 高频数字电路PCB
设计中的布局与布线 2.4.3 混合信号电路PCB设计中的布局与布线 2.4.4 单片机系统PCB设计 2.5
PCB电磁兼容设计中的地线设计 2.5.1 地线阻抗干扰 2.5.2 地线环路干扰和抑制 2.5.3 公共阻抗耦
合干扰和抑制 思考题与练习题 实训：拆装计算机 第3章 电子整机装配工艺 3.1 整机装配工艺过程
3.1.1 整机装配工艺过程 3.1.2 流水线作业法 3.1.3 整机装配的顺序和基本要求 3.1.4 整机装配的
特点及方法 3.2 电子整机装配前的准备工艺 3.2.1 搪锡技术 3.2.2 元器件引线的成形和屏蔽导线的
端头处理 3.2.3 电缆的加工 3.3 印制电路板的组装 3.3.1 印制电路板装配工艺 3.3.2 印制电路板组
装工艺流程 3.4 整机调试与老化 3.4.1 整机调试的内容和程序 3.4.2 整机的加电老化 思考题与练
习题 实训1：简易印制电路板的制作 实训2：组装电子节拍器 实训3：电视机整机装配工艺过程
第4章 Protel DXP基础 4.1 Protel DXP软件介绍 4.2 Protel DXP工作总体流程 4.3 Protel DXP设计环境
4.3.1 Protel DXP设计环境 4.3.2 Protel DXP组成 4.4 Protel DXP的文件管理 思考题与练习题 第5章 原
理图设计基础第6章 制作元件及元件封装 第7章 印制电路板的设计 附录A 工艺文件封面 附录B
工艺文件明细表 附录C 工艺流程图 附录D 导线及线扎加工卡 附录E 装配工艺过程卡 附录F 材料消耗
工艺定额明细表 参考文献

<<电子工艺与电子CAD>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>